

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-048

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	易天股份	股票代码	300812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王亚丽	莫凤艳	
电话	0755-27850601	0755-27850601	
办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401	深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401	
电子信箱	IR@etmade.com.cn	IR@etmade.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	304,359,338.50	158,181,382.89	92.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,965,645.75	-33,595,745.92	189.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,601,101.68	-33,826,834.78	184.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,135,658.34	-12,609,049.82	727.61%
基本每股收益（元/股）	0.21	-0.24	187.50%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-0.24	187.50%
加权平均净资产收益率	3.82%	-3.85%	7.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,441,037,366.99	1,443,687,607.08	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	799,170,492.07	768,127,046.31	4.04%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,050	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份 的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柴明华	境内自然人	16.79%	23,520,500	17,640,375	不适用	0
高军鹏	境内自然人	14.10%	19,744,300	14,808,225	质押	5,000,000
胡靖林	境内自然人	8.54%	11,966,000	8,974,500	不适用	0
深圳市易天恒投 投资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	7.32%	10,259,500	0	不适用	0
陈飞	境内自然人	2.37%	3,326,000	2,569,500	不适用	0
康宏刚	境内自然人	2.28%	3,193,500	2,395,125	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.75%	1,057,412	0	不适用	0
周玉兰	境内自然人	0.70%	980,000	0	不适用	0

徐来	境内自然人	0.60%	840,490	630,367	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.51%	710,483	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林三人签署《一致行动协议》，因此柴明华、高军鹏、胡靖林三位股东属于一致行动人。同时，三人通过《一致行动协议》共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）公司从事的主要业务、主要产品

公司是一家专业从事平板显示专用设备及半导体专用设备自主研发、生产与销售的高新技术企业，致力于“成为全球最好的专用设备提供商”，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。公司主要产品类别包括 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备、传

统封装设备及先进封装设备。公司深化智能制造装备领域战略布局，以在贴附、清洗、绑定、脱泡、检测等工艺环节多年的技术沉淀为基础，构建了平板显示和半导体两大行业业务主线，不断推进技术革新、扩展客户资源、优化经营模式、提升市场服务，积极拓展在平板显示专用设备及半导体专用设备领域的市场份额。



公司主要设备类别及应用

（二）公司所处的行业地位情况

公司专业为客户提供平板显示专用设备及半导体设备整体解决方案，提供国产化设备，实现进口替代，为客户降本增效。自公司设立以来，始终专注于智能制造装备领域，持续推出技术先进、性能优异的系列产品。依靠先进的技术、稳定的产品质量、完善的售后技术支持，公司产品获得了一线平板显示类客户及半导体设备类客户的高度认可，并成为其重要的专用生产设备供应商，市场知名度和美誉度较高。

1、平板显示专用设备行业

在 LCD 显示设备领域，公司凭借过硬的产品质量、技术创新能力以及高效优质的配套服务能力，已与国内众多的面板厂商建立了深度合作，部分设备类产品实现进口替代。公司在 LCD 显示领域实现后道模组段全覆盖，已具备 130 寸以下整线组装能力，主要的生产工艺流程包括清洗设备、偏光片贴附设备、全贴合设备、AOI 检测设备、脱泡设备、贴膜/覆膜设备、背光组装设备、绑定设备等，已经与包括京东方、深天马、华星光电、福米科技、惠科股份、杉金光电、恒美光电、三利谱等头部面板厂商和材料厂商建立长期良好的合作关系。公司在中大尺寸 LCD 后段整线工艺的技术先驱性较强、技术优势较明显、大型项目资源优势较突出，在整线工艺设备保证节拍的前提下，植入全段工艺闭环检测，有效控制产品品质。随着国内显示面板厂商的产能向海外拓展，公司依托客户信任随客户出海，与华星光电（印度/越南），璨宇光电（越南），蓝思科技（越南/泰国），无锡夏普（越南）等海外区域工厂建立了良好的合作。同时，受益于中国新能源汽车快速发展，公司在车载显示方面的相关设备，如点胶穿孔背光组装设备、异形双联屏真空全贴合设备等出货加速，并获得了京东方、华星光电、深天马、武汉海微、华安鑫创等客户订单。

在柔性 OLED 显示设备领域，主要设备类型包括柔性偏贴设备、贴合设备、AOI 检测设备、脱泡设备、出货膜和制程膜设备等。公司研发并推出的全自动柔性面板偏光片贴附设备，取得了包括京东方、维信诺、深天马、华星光电等客户的认可；研发并推出的柔性面板制作工艺中所需的膜材贴附设备，如面板取下前清洗设备、取下后覆膜设备等相关设备也获得了华星光电等客户的认可。报告期内，公司已获得京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目订单，柔性 OLED 覆膜设备已在合肥维信诺相关产线完成验证。依托于在面板贴附领域的领先技术，公司已成为国内柔性面板制造厂商的首选合作厂商之一。

在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的 Micro OLED（硅基 OLED）晶圆显示偏光片贴附设备、PF 膜材贴附设备、OCA 贴合设备、HTH 全贴合设备、光机组装设备、全自动化检测类设备等，基本涵盖了 VR/AR/MR 工艺段中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备，相关产品现已取得视涯科技等客户的认可。同时，公司推出的 VR/AR/MR 制造工艺中所需膜材制造的覆膜设备，获得三利谱、歌尔股份、宁波诚美、芜湖微显、梦显科技等客户的认可，并已展开合作。报告期内，公司在 VR/AR/MR 显示领域的相关贴附设备市场份额持续提升，与视涯科技共同推进如 OTP 自动化设备、检测贴合设备等项目，成功获得了京东方、眉山微显等客户订单。同时，公司持续加大研发投入，在配套自动化检测设备技术工艺上取得显著突破。

2、半导体专用设备行业

公司控股子公司微组半导体专注于全自动微米级高精度微组设备、Mini LED 返修设备的研发，是一家集设计、生产和销售、服务为一体的半导体微组设备专业制造商，其产品主要有 Mini LED 产品线和封装设备产品线，可适用于 IC 集成电路封装、Mini/Micro LED 返修、高速光模块的组装、射频器件、微波器件、MEMS 传感器、医疗 X 射线探测器、IGBT 模块等器件的封装，可实现部分国产设备替代进口设备。公司控股子公司易天半导体是一家集自主研发、设计、生产和销售和服务于一体的半导体专用设备制造商，具备 Mini/Micro LED 巨量转移全工艺段自动线设备及晶圆减薄相关半导体设备研发和制造能力。

在 Mini/Micro LED 设备领域，微组半导体自主研发生产的 AM-10HB 贴片机是 Micro LED 微显示屏生产的主要封装设备之一，且已和上海显耀建立合作关系。微组半导体已开发了 Mini LED 固晶后修复技术、回流焊接后修复技术、模压后一体化修复技术、Mini LED 灯带全自动点亮检测及返修设备；Mini LED 返修类设备可用于直显、背光的 Mini LED 显示模组生产制造。易天半导体专注于 Mini LED 巨量转移整线设备的研发和制造，已与显示行业多家头部客户共同进行玻璃基和 PCB 基的芯片巨量转移的工艺验证。

在传统封装设备领域，公司基于十八年来贴附类研发生产技术的沉淀积累，开发生产出半导体相关的覆膜设备，得到了包括三安光电、通富微电、歌尔股份、华天科技、燕东微电子等客户的认可。易天半导体对晶圆减薄相关的第一代设备进行了优化升级，经过客户多次试样验证，该设备操作性能稳定、加工精度高，在加工速度及品质上向行业龙头企业

业技术水平看齐，可实现部分进口替代。在医疗器械设备方面，微组半导体开发的 X 射线探测器模块微组装生产线，在医疗器械断层扫描 CT 机生产工序中起到了重要的国产化替代作用，获得了医疗行业客户航卫通用、联影医疗、同方威视、奕瑞影像科技、东软医疗等客户的认可。在 IGBT 设备方面，微组半导体专注于微组装工艺及装备的研发，重点开发高速、高精度、多功能、全自动半导体封装设备，已开始进入 IGBT 专用贴片机领域；微组半导体推出的专用贴片机，取得了峻凌电子订单。

在先进封装设备领域，微组半导体以倒装贴片技术为核心不断提升 Chiplet 专用设备产品性能，丰富产品线，涵盖了 Dipping/TCB/USC/覆膜等工艺，相关产品可用于 SIP（系统级封装）、MEMS 器件、射频器件、微波器件和混合电路的微组装，已取得了日月新半导体、高通、长电科技等客户订单。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日